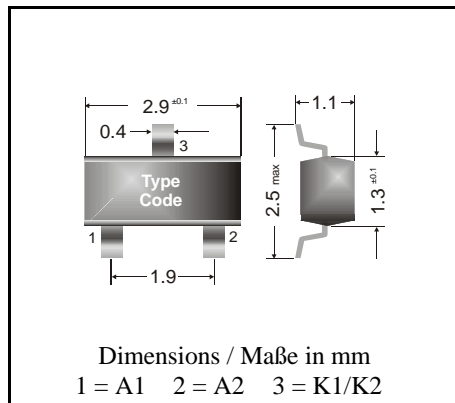


Surface mount Small Signal Double-Diodes Kleinsignal-Doppel-Dioden für die Oberflächenmontage

Version 2004-01-27



Power dissipation – Verlustleistung	310 mW
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	70 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	SOT-23 (TO-236)
Weight approx. – Gewicht ca.	0.01 g
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	

Maximum ratings (T_A = 25°C)**Grenzwerte (T_A = 25°C)**

per diode / pro Diode		BAV70
Power dissipation – Verlustleistung	P _{tot}	310 mW ¹⁾
Max. average forward current (dc) Dauergrenzstrom	I _{FAV}	200 mA ¹⁾
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	I _{FRM}	300 mA ¹⁾
Peak forward surge current Stoßstrom-Grenzwert	t _p ≤ 1 s t _p ≤ 1 ms t _p ≤ 1 μs	I _{FSM} I _{FSM} I _{FSM} 0.5 A 1 A 2 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	V _{RRM}	70 V
Junction temperature – Sperrschichttemperatur	T _j	150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T _s	- 55...+ 150°C

Characteristics (T_j = 25°C)**Kennwerte (T_j = 25°C)**

Forward voltage - Durchlaßspannung ²⁾	I _F = 1 mA	V _F	< 715 mV	
	I _F = 10 mA	V _F	< 855 mV	
	I _F = 50 mA	V _F	< 1 V	
	I _F = 150 mA	V _F	< 1.25 V	
Leakage current - Sperrstrom ²⁾	V _R = 70 V	T _j = 25°C	I _R	< 5 μA
	V _R = 25 V	T _j = 150°C	I _R	< 60 μA
	V _R = 70 V	T _j = 150°C	I _R	< 100 μA

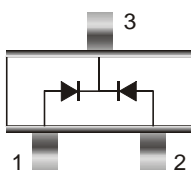
¹⁾ Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluß

²⁾ Tested with pulses t_p = 300 μs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen t_p = 300 μs, Schaltverhältnis ≤ 2%

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

Max. junction Capacitance – Max. Sperrschichtkapazität $V_R = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	C_T	1.5 pF
Reverse recovery time - Sperrverzug $I_F = 10\text{ mA}$ über / through $I_R = 10\text{ mA}$ bis / to $I_R = 1\text{ mA}$	t_{rr}	< 6 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft	R_{thA}	420 K/W ¹⁾

Outline – Gehäuse	Pinning – Anschlußbelegung	Marking – Stempelung
	<p>Double diode, common cathode Doppeldiode, gemeins. Katode</p> <p>1 = A1 2 = A2 3 = K1 / K2</p>	<p>BAV70 = A4 or / oder = JJ</p>

¹⁾ Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluß